「共創型化学会社」
- 世界トップクラスの機能性化学メーカーへの変革 -

株式会社レゾナック・ホールディングス
代表取締役社長　社長執行役員　最高経営責任者（CEO）
髙橋 秀仁

2024年2月14日

私たちがお伝えしたいこと

RESONAC

持続可能な成長と**市場革新の道**を切り開くことで
半導体材料業界におけるリーダーとして業界を先導していく

Say&Do 1

半導体成長分野への積極投資

Say&Do 2

共創型イノベーション創出加速

Say&Do 3

カルチャー変革 & 人材開発

Agenda

1. レゾナックの目指す姿
2. 半導体成長分野への積極投資
3. 共創型イノベーション創出加速
4. カルチャー革新&人材開発

RESONAC

©Resonac Corporation All Rights Reserved.

Agenda

1. レゾナックの目指す姿
2. 半導体成長分野への積極投資
3. 共創型イノベーション創出加速
4. カルチャー革新&人材開発

RESONAC

©Resonac Corporation All Rights Reserved.

RESONAC

Purpose 存在意義

化学の力で社会を変える

先端材料パートナーとして時代が求める機能を創出し、
グローバル社会の持続可能な発展に貢献する

RESONAC
Chemistry for Change

Values 私たちが大切にする価値観

- ▶ プロフェッショナルとしての成果へのこだわり
- ▶ 機敏さと柔軟性
- ▶ 枠を超えるオープンマインド
- ▶ 未来への先見性と高い倫理観

©Resonac Holdings Corporation All Rights Reserved.

ビジョン：私たちの目指す姿

RESONAC

レゾナックの目指す姿

共創型化学会社

化学企業としてグローバルにおける一流の実力を備え、
機敏かつ柔軟な行動と意思決定をもって、
産業のキープレイヤーから生活者に至るまで
志を共にする仲間とよりよい社会を共創していく

×

世界トップクラスの機能性化学メーカー

日本の化学メーカーとして培ってきた良さを活かしつつ、
グローバル企業の高度な経営手法を取り入れることで
様々な社会課題を解決する

長期的な成長に向けて

RESONAC

レゾナックの長期ビジョン 2030年に目指す姿

2030

Our Vison

- 世界で戦える会社
- 持続可能なグローバル社会に貢献する会社
- 国内の製造業を代表する共創型人材創出企業

Action 2

- 半導体事業への経営資源集中

Action 1

- ポートフォリオ改革
- CXO体制確立

- カルチャーの革新&人材開発

達成のための主要戦略

グローバル水準収益基盤確立	ポートフォリオ高度化	イノベーション推進	経営基盤強化

©Resonac Holdings Corporation All Rights Reserved.

Agenda

1. レゾナックの目指す姿
2. **半導体成長分野への積極投資**
3. 共創型イノベーション創出加速
4. カルチャー革新&人材開発

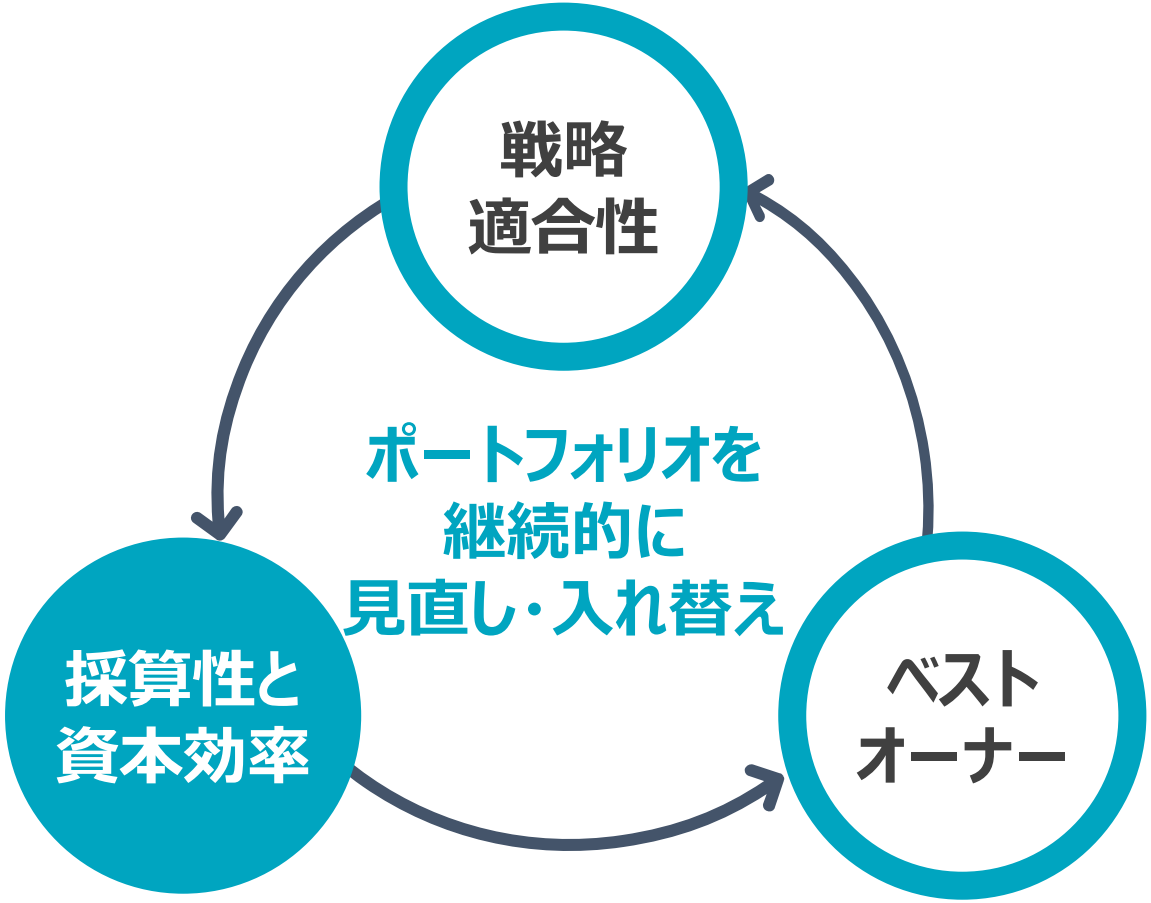
RESONAC

©Resonac Corporation All Rights Reserved.

事業ポートフォリオ改革

RESONAC

ポートフォリオ改革の考え方



ポートフォリオ最適化に向けた流れ

2021	**昭光通商**(商社：化学品などの販売)
	アルミ缶事業
	食品包装用ラップフィルム事業
	アルミ圧延品事業
	プリント配線板事業
	蓄電デバイス・システム事業
2022	**セラミック事業**
	ISOLITE(自動車等の断熱部品事業)
2023	**診断薬事業**

9つの事業を売却

©Resonac Holdings Corporation All Rights Reserved.

RESONAC

石油化学事業のパーシャル・スピンオフ検討開始

株主

分割対価

RESONAC

半導体・電子材料の業界再編に向けた取組みを加速

- ✓ 半導体・電子材料に経営資源を集中
- ✓ 機能性化学メーカーとして高い成長性を実現

(分割会社)
石油化学事業

New Co.

石油化学事業のサステナブルな発展・進化を実現

- ✓ 石油化学のGXに向けた新たな取組みを加速
- ✓ 独立企業としてオペレーショナルエクセレンスを追求

(承継会社)
石油化学事業

分割

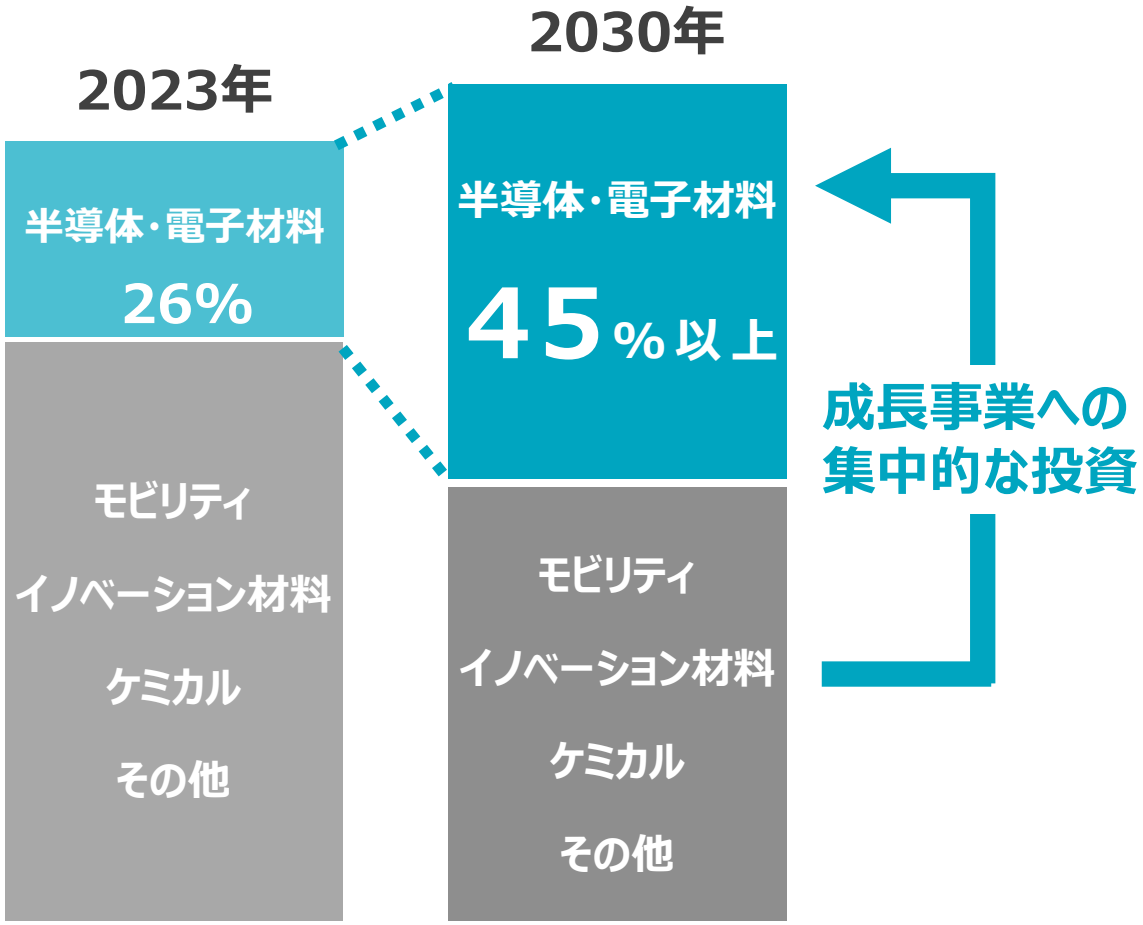
*本スピンオフの実行予定時期は未定ですが、2~3年後の実行を念頭に置き、今年度末に向けて検討を進めて参ります。当該検討の中には、承継会社の株式を上場する市場、日本や米国をはじめとする各国における税制適格要件の充足可能性等が含まれ、本スピンオフの実行は、証券取引所その他の関係当局、ステークホルダーの承認や認定、許認可等の取得を前提としています。

©Resonac Holdings Corporation All Rights Reserved.

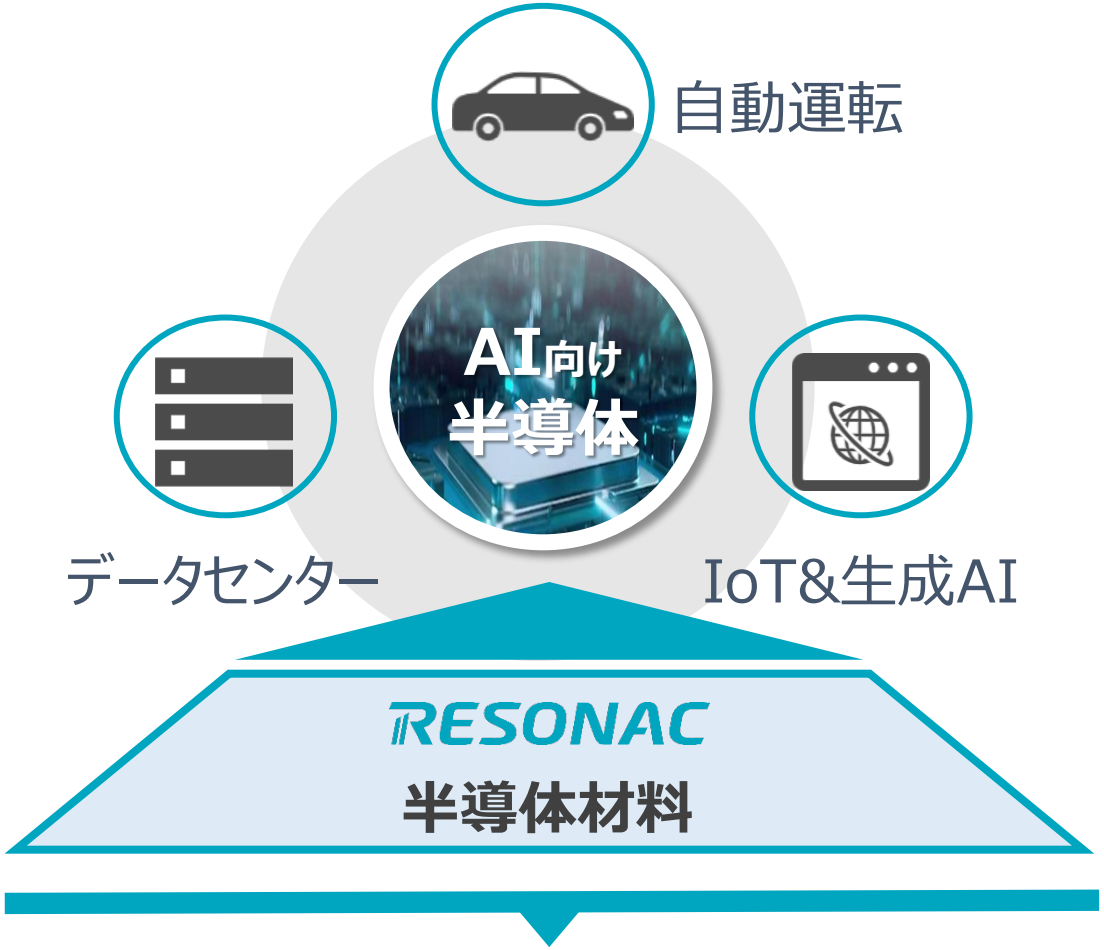
半導体材料を核にした全社利益成長を実現

RESONAC

メリハリある経営資源配分



市場成長の期待高い半導体事業に特化



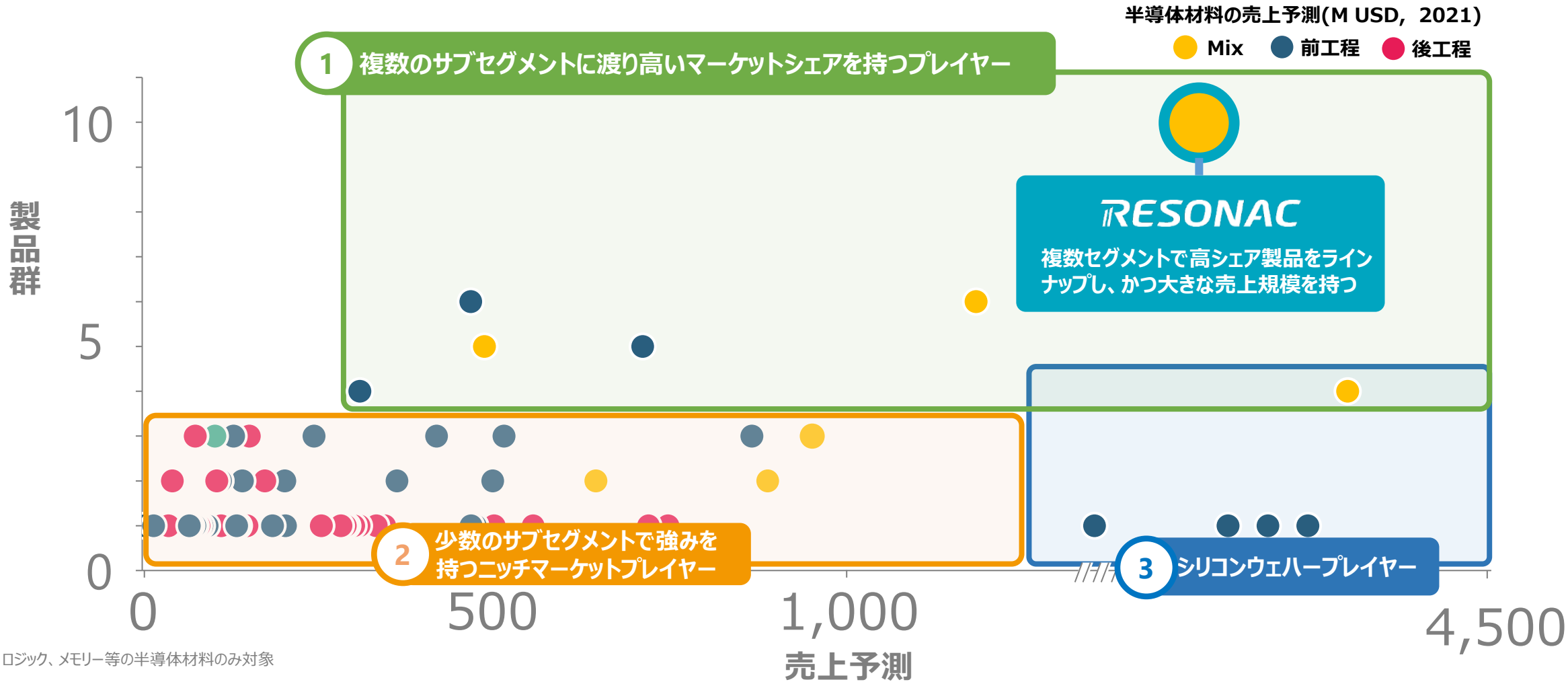
AI進展を通じ半導体材料業界の変革をリード

©Resonac Holdings Corporation All Rights Reserved.

半導体材料のリーダー：ユニークなポジションと顧客への提案力

RESONAC

レゾナックは半導体分野の**複数セグメント**で**高シェア製品**をラインナップし、顧客の要求に合わせて、**柔軟にすり合わせ**対応可能



ロジック、メモリー等の半導体材料のみ対象

出典：「半導体材料市場の現状と将来展望」(富士経済, 2020年/2022年), 2022年BCG分析

©Resonac Corporation All Rights Reserved.

変化する半導体と材料ニーズ

RESONAC

データ増加に伴いチップ・部材ごとの個別設計からパッケージ全体での機能実現へ

前工程材料の技術革新から　後工程材料の提案力が競争力の源泉に

前工程（ウエハ上に回路を形成）

回路プロセスは数nmまで微細化。
微細化は限界に近付きつつある

後工程（半導体チップのパッケージング）

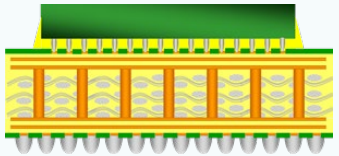
パッケージングの技術革新に注目が集まる

半導体の高集積化に伴い、設計プロセスは高度かつ複雑なものへ

従来からのパッケージ

簡素なチップ×１つ

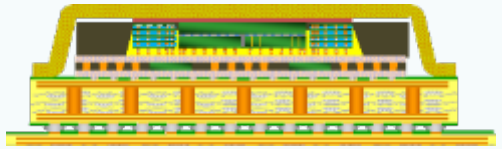
材料単体評価



高集積化したチップ×１つ

組合せ評価

最先端のパッケージ



高集積化したチップ×複数

パッケージレベル
総合評価

©Resonac Corporation All Rights Reserved.

レゾナックのAI半導体材料と統合ソリューション

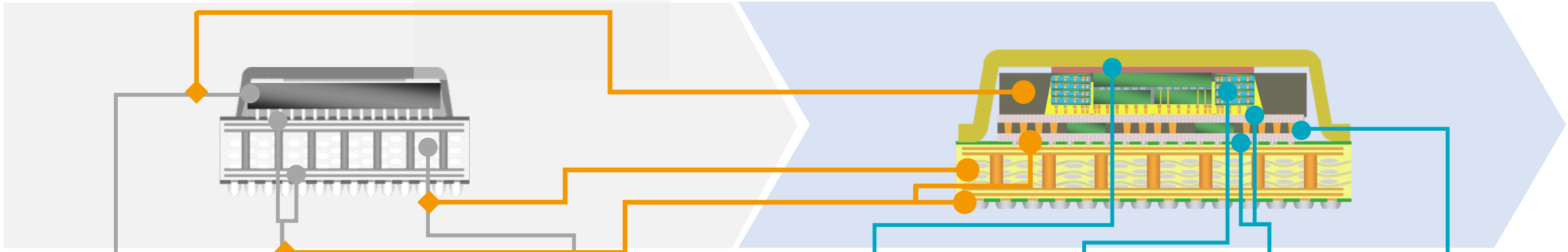
RESONAC

従来の実績ある材料を基盤に

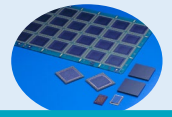
部品点数増加と半導体大型化による材料需要が拡大し、当社ビジネスを牽引

従来半導体

AI向けプロセッサ



固形封止材



世界シェア2位

ソルダーレジスト
(大型パッケージ基板向け)

世界シェア1位

銅張積層板

世界シェア1位

＋

熱伝導材(TIM)

世界シェア1位

ノンコンダクティブ
フィルム

世界シェア1位

アンダーフィル

世界シェア2位

感光性(絶縁)材

上市開始

共通材料として展開

新規に提供する材料群

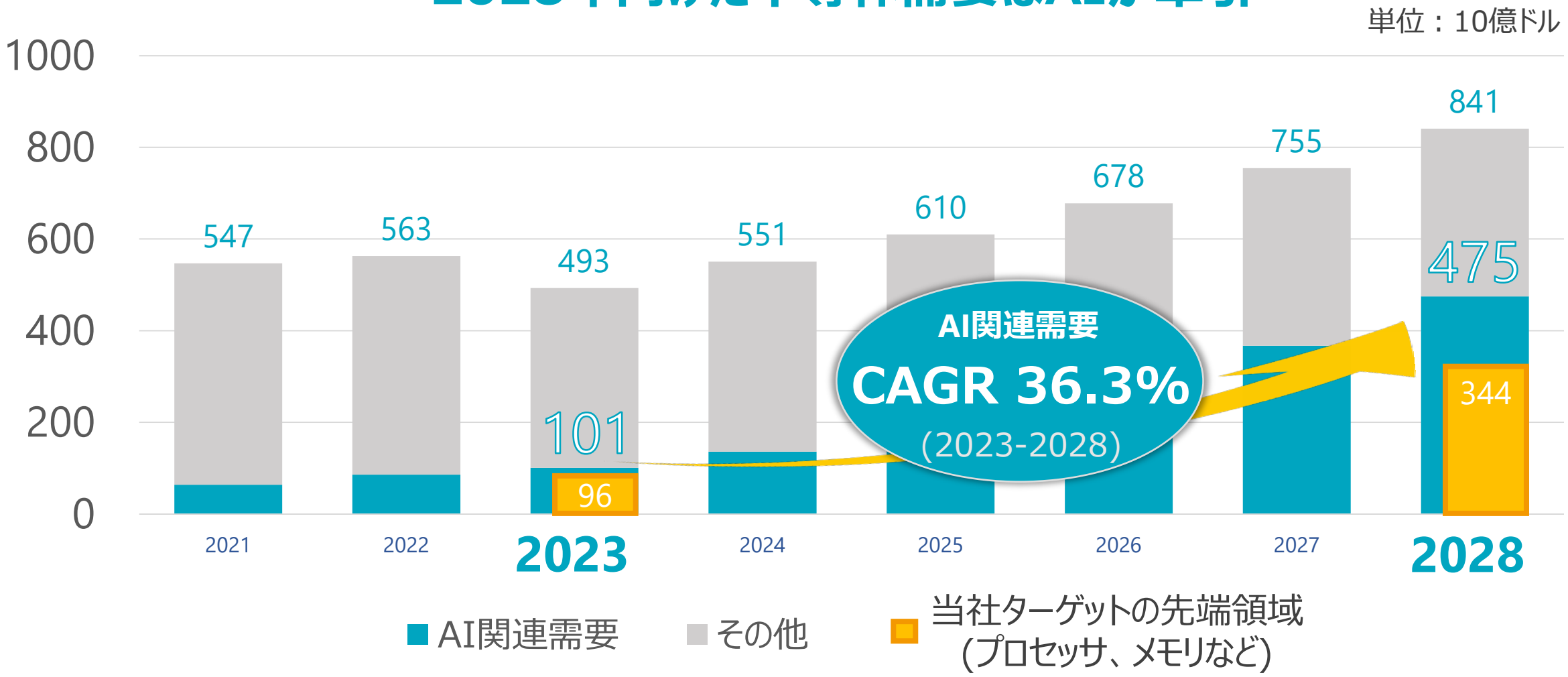
©Resonac Corporation All Rights Reserved.

半導体の全体的市場動向とAI向け半導体の市場展望

RESONAC

半導体市場は成長の踊り場を脱出し、引き続き伸長

2028年向けた半導体需要はAIが牽引



出典：INTERNATIONAL BUSINESS STRATEGIES, INC., OCTOBER 2023

©Resonac Corporation All Rights Reserved.

半導体業界へ新規参入するGAFAM

RESONAC

最新のAI半導体設計がシリコンバレーに集中
GAFAMは、生成AIニーズに最適化した独自チップを自社開発

AIサーバー向け半導体のサプライチェーン

半導体ユーザー	半導体メーカー		
データセンター（生成AI関連）	設計	前工程	後工程
Google Apple Meta Amazon Microsoft	Intel AMD nVIDIA	Intel TSMC Samsung	Intel TSMC OSAT各社

GoogleやAmazonがAI半導体を自社開発

GAFAMが次々と半導体業界へ参入

©Resonac Corporation All Rights Reserved.

海外戦略①：先端パッケージコンセプトリーダー・材料・装置メーカー 共創

RESONAC

GAFAMや半導体メーカーが

集積する「米国シリコンバレー」に

パッケージングソリューションセンター設置予定

導入設備の検討、調査など準備開始

2024年　試験運用開始

2025年　フルスケール操業開始

©Resonac Corporation All Rights Reserved.

海外戦略②　：2.xD、3Dパッケージ技術の開発スピードを加速

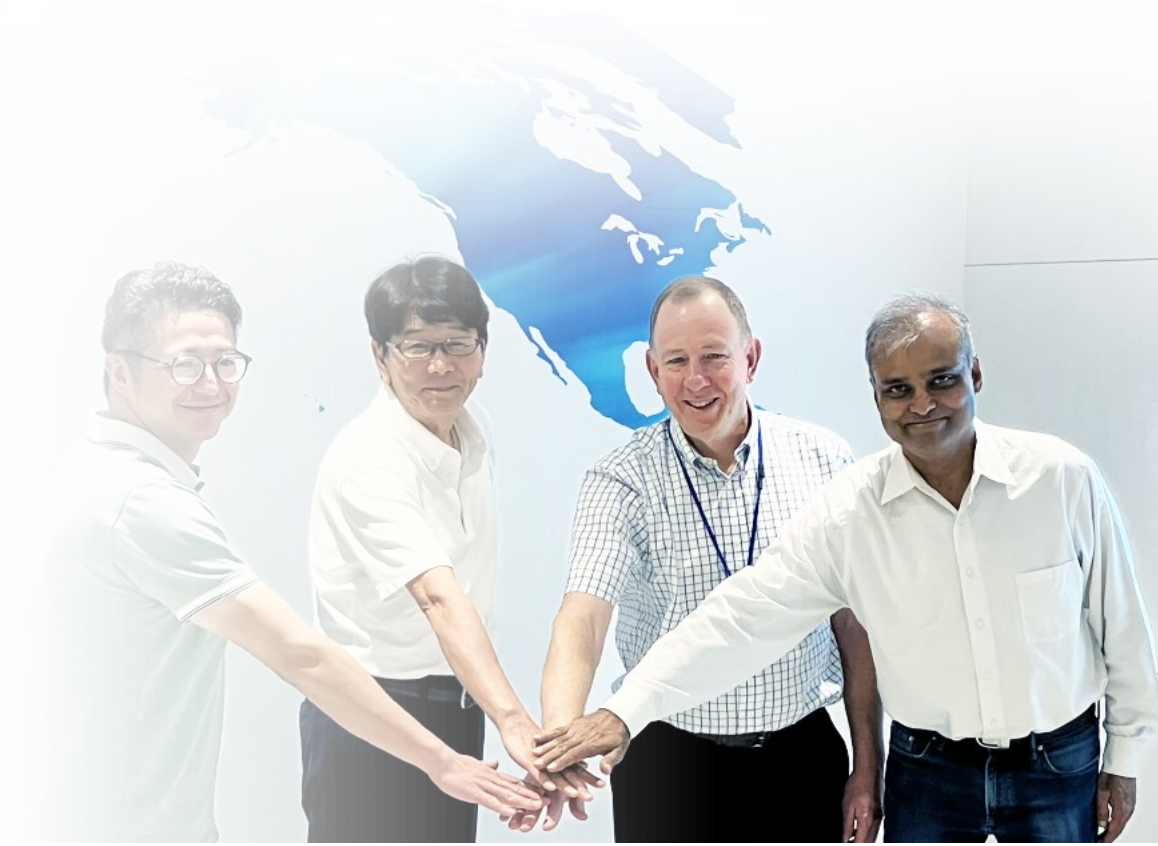
RESONAC

米国大手半導体ビジネスが結集する

先端半導体コンソーシアム「TIE」※1参画

材料メーカーとして初、
非米国企業としても初の戦略的パートナー※2

2024年後半から
2.xD、3Dパッケージ試作ライン立上



※1　Texas Institute for Electronics：米国テキサス大学オースティン校が主導する非営利団体。テキサス州、半導体企業、研究所、学術機関など産官学で構成。
※2　2023年10月末時点

©Resonac Corporation All Rights Reserved.

Agenda

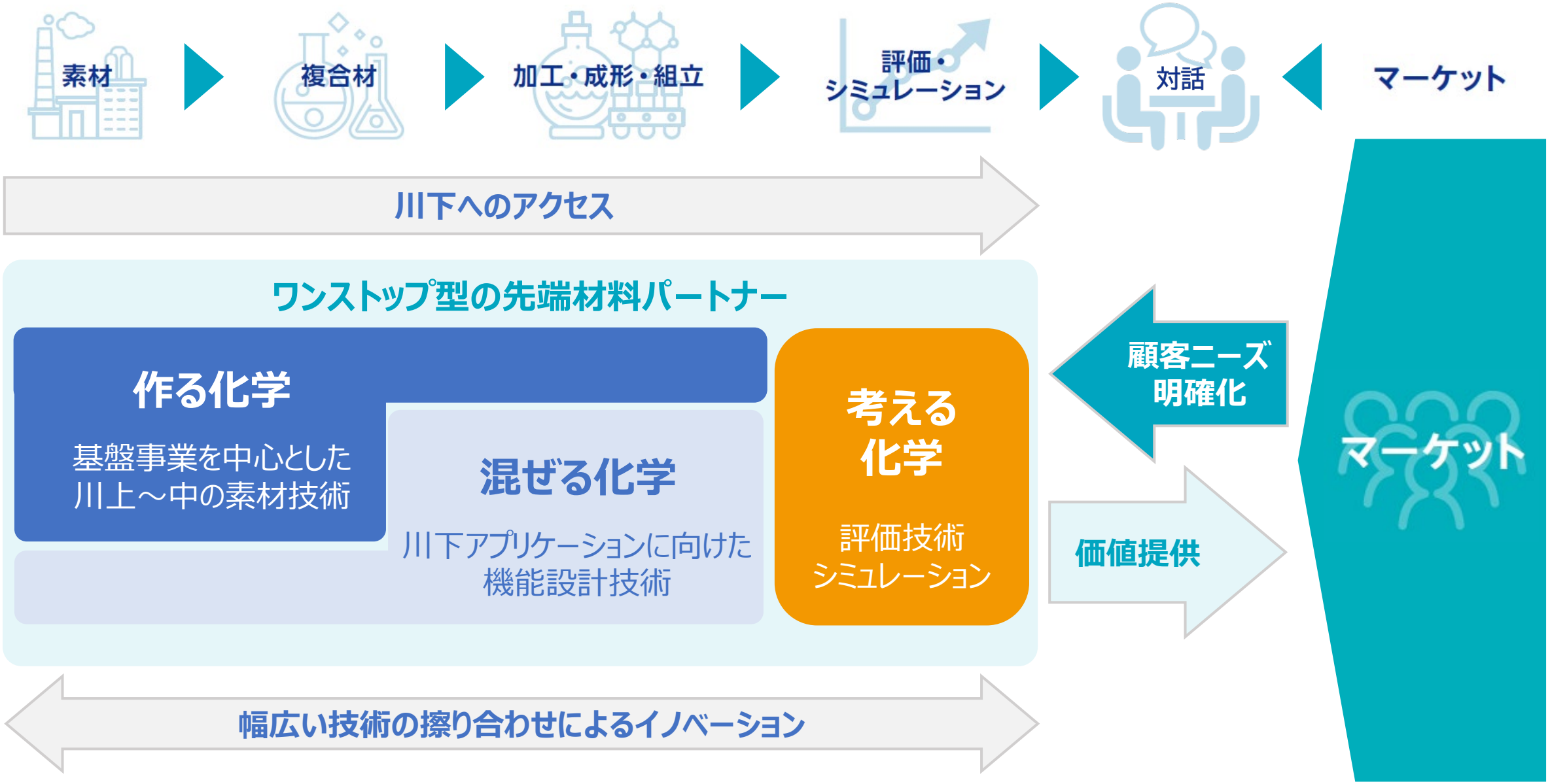
1. レゾナックの目指す姿
2. 半導体成長分野への積極投資
3. **共創型イノベーション創出加速**
4. カルチャー革新&人材開発

RESONAC

©Resonac Corporation All Rights Reserved.

共創型イノベーション 価値創造モデル

RESONAC



©Resonac Corporation All Rights Reserved.

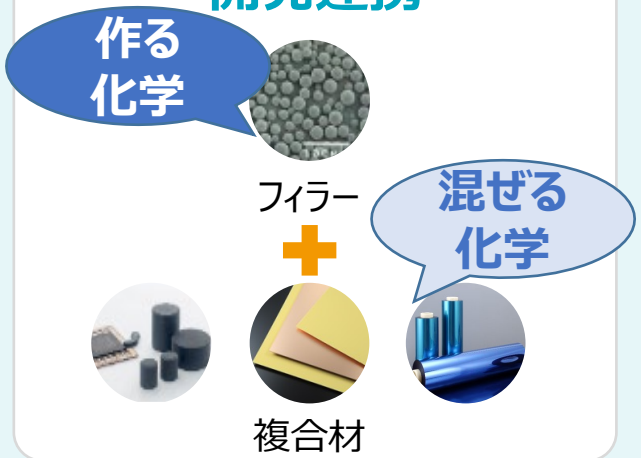
連携・深化・強化による共創型イノベーション創出加速

RESONAC

「作る」と「混ぜる」の連携

開発統合による
機能性向上と効率化

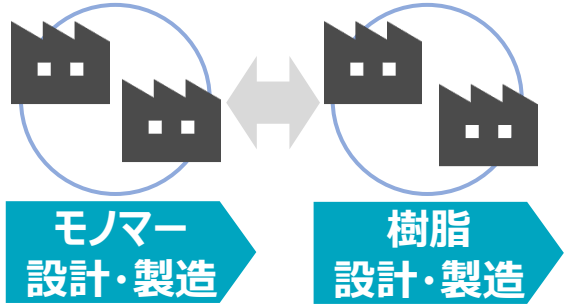
**フィラー・複合材
開発連携**



「作る化学」の深化

モノマー/樹脂
設計・製造の拠点間連携

**有機合成
素材開発深化**



「考える化学」の強化

テクノロジーリーダーの顧客に
追随し、評価技術開発

**パワーモジュール
インテグレーションセンター**

研究開発を加速させる
プラットフォーム

**計算情報
科学研究センター**

“共創型イノベーション”の組み合わせパターン例

- 機能性材料 ⚙ 半導体材料
- 事業所 ⚙ 事業所
- 半導体材料 ⚙ 解析評価
- 半導体材料 ⚙ 計算科学

©Resonac Corporation All Rights Reserved.

計算情報科学が支える　半導体材料開発のイノベーション

RESONAC

計算情報科学がもたらす従来にはない半導体材料の製品開発

高速開発と圧倒的知財力で”共創型イノベーション”を新たな次元へ

計算・情報科学融合による多彩な材料の高速開発

計算科学
(分子/構造・流体シミュレーション)

情報科学
(AI、MI、画像解析等)

材料検査時間

5か月 → **1日**

(理論値:全数目視)　(ディープラーニング)

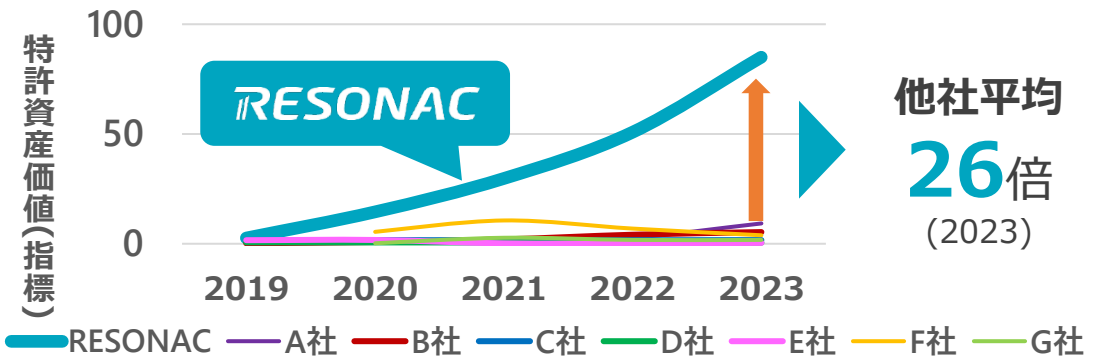
材料開発期間

1/5に短縮

(熟練者配合選定から'AI配合→試作')

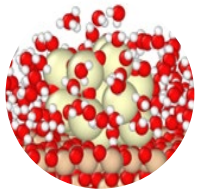
特許資産の世界トップクラスがもたらす競争優位

マテリアルズ・インフォマティクスの特許資産価値※1の
半導体材料・化学各社との比較



他社平均
26倍
(2023)

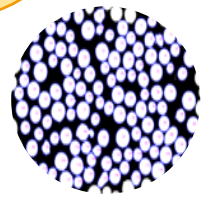
探索効率向上



CMPスラリー添加剤候補
効率的絞り込み
(量子化学計算活用)

CMP※2スラリー ✿ 分子計算 ✿ AI

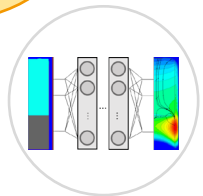
品質向上



材料検査自動化で
検査時間短縮・バラつき抑制
(画像解析)

ACF※3 ✿ ディープラーニング

開発期間短縮



高温プロセスを仮想環境で
再現し、大口径・高品質を両立
(熱流体シミュレーション×AI活用)

SiC ✿ シミュレーション ✿ AI

※1 特許資産価値： LexisNexis社 PatentSight®にて弊社独自のMI集合よる技術的価値と市場的価値を掛け合わせた総和 ※2 CMP:化学的機械研磨 ※3 ACF：異方導電フィルム

成長に向けた他社との共創

パッケージング ソリューションセンター

他社と共に
次世代半導体技術革新に挑む

共創の舞台

レゾナックR&Dの中核となる
オープンイノベーション拠点

イノベーションセンター

共創の種を生み出す
コミュニケーションスペース

Agenda

1. レゾナックの目指す姿
2. 半導体成長分野への積極投資
3. 共創型イノベーション創出加速
4. カルチャー革新&人材開発

RESONAC

©Resonac Corporation All Rights Reserved.

長期的な成長に向けて

RESONAC

2022年　～2025年　～2030年

チームで実行

CXO
体制確立

ポートフォリオ改革
万全な収益基盤

より長期的な課題に
CEO自ら注力・推進

価値観を共有し、
変革をやりきる人材が、
適度な緊張感を持ち、
自律的に働く会社

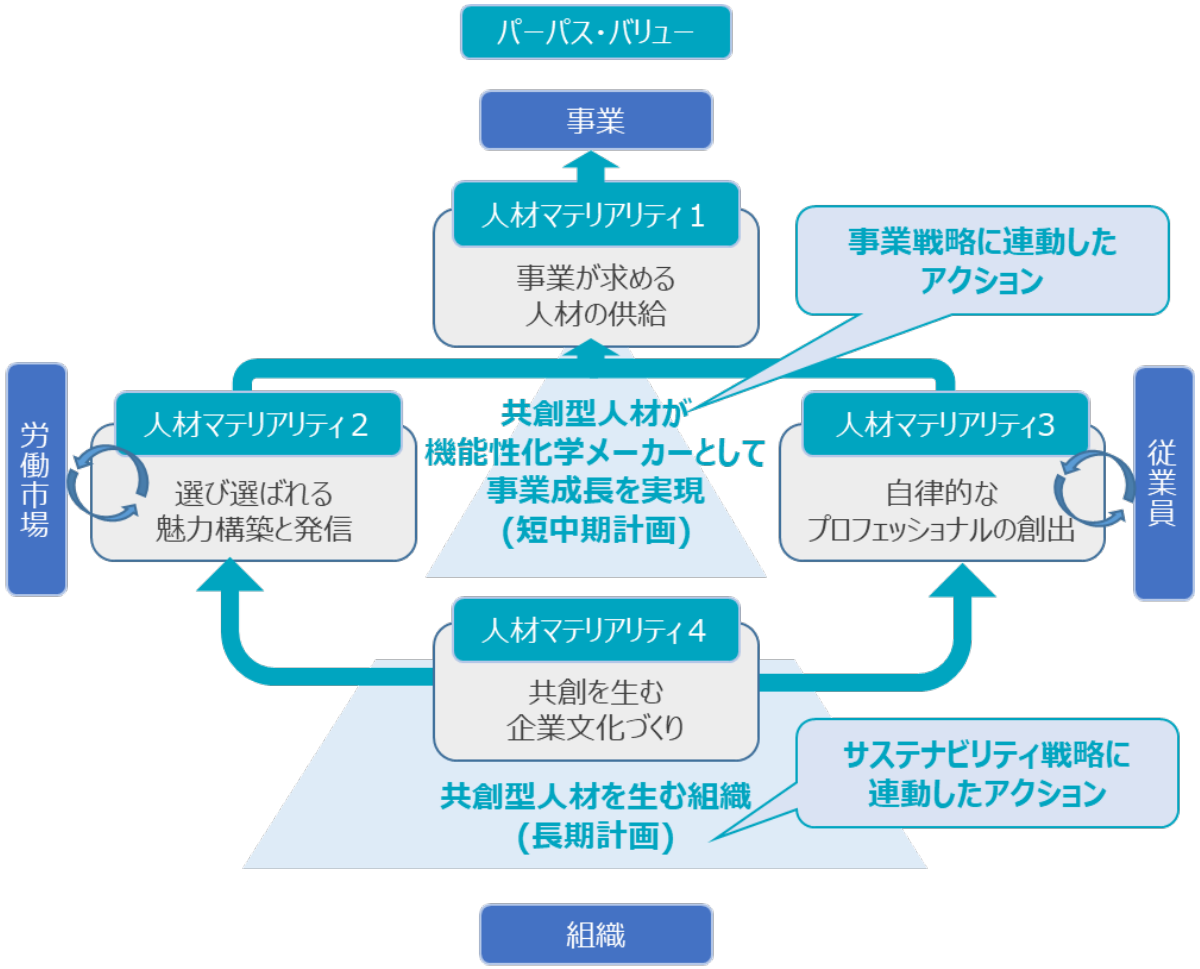
私たち一人ひとりによる
パーパス・バリューの自分ごと化と実践

©Resonac Holdings Corporation All Rights Reserved.

人的資本施策を支える基盤構築に向けた取り組み

RESONAC

レゾナックの人材戦略



人材マテリアリティとKGI

	人材マテリアリティ	KGI
1	事業が求める 人材の供給	将来人材ポートフォリオ充足率 後継者計画準備率
2	選び選ばれる 魅力構築と発信	採用計画の充足率 痛手となる自発的離職率 エンゲージメントスコア
3	自律的な プロフェッショナルの 創出	内部登用率 （重要ポジション）
4	共創を生む 企業文化づくり	パーパス・バリュー実践度の サーベイスコア

©Resonac Holdings Corporation All Rights Reserved.

人材マネジメントに向けたグローバル基盤構築

RESONAC

グローバル人材マネジメントシステム構築により
人材・スキル可視化による事業戦略に合わせた動的人材ポートフォリオ運営実現と経営コア人材早期選抜と戦略的育成推進

2022

- 両社役員統合
- 人事システム導入準備
- 経営コア人材早期選抜の枠組み検討
- タレントレビュー導入開始
- CxO/BU長後継者計画作成（システム外で実施）

2023

法人統合

- 人事制度統合（国内）
- 人事システム導入（主に国内）
- 経営コア人材候補選抜・育成（国内）
- 後継者計画・タレントレビュー実施（国内）
- HRビジネスパートナー構築

2024

- グローバル展開
  - グローバル等級導入
  - MBO統一
  - 経営コア人材候補選抜・育成
  - 後継者計画・タレントレビュー
- RHQ体制構築

ありたい姿

- 事業スピードに合わせた動的人員構成、適材適所実現
- 経営コア人材候補の登用、戦略的育成、多様な人材プール形成
- グローバル社内公募等による自律的キャリア形成実現

©Resonac Corporation All Rights Reserved.

共創型人材を育成する文化醸成への取り組み

RESONAC

課題認識と取り組み効果

モヤモヤしていること、関心事を
オープンに議論し、解決に向けて
共に取り組める文化の醸成

パーパス・バリューの実践度
約5割に向上(2022年比+16pt)

モヤモヤに共感してくれることで安心感が得られた

他部門のモヤモヤから新たな気付きが生まれた

髙橋さん・今井さんに対して自分の考えを率直に言えること、言える環境があることに驚いた

具体的な取り組み(2023年)

モヤモヤ会議
双方向コミュニケーション
CEO・CHRO主催

タウンホールミーティング

半径14mの共創ブック
共創の考え方をまとめたハンドブック

AHA!
(Award of Harmony)
グローバルアワード
(共感・共創の機会)

REBLUC
(Resonac Blue Creators)
パーパスドリブン思考のコミュニティ

モヤモヤ会議

34回(824人)

タウンホールミーティング

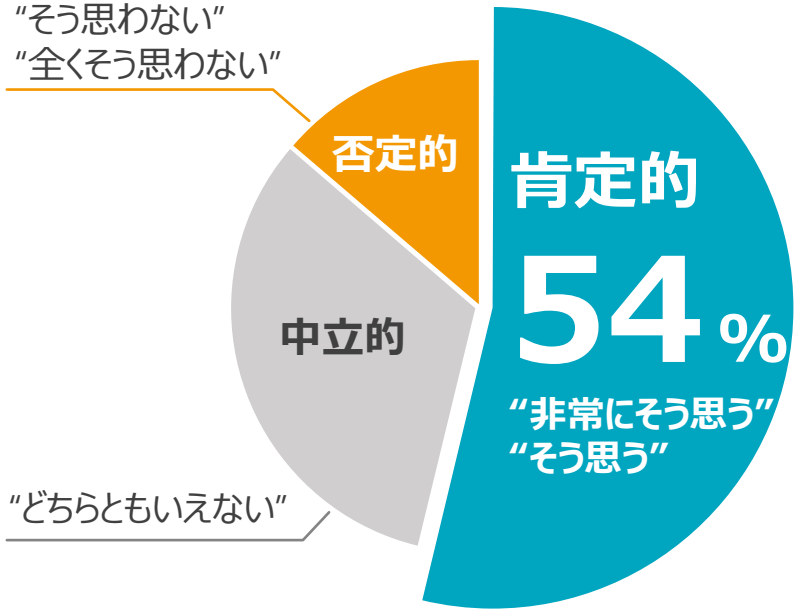
63回実施

©Resonac Holdings Corporation All Rights Reserved.

Keyは双方向コミュニケーション：心理的安全性の更なる向上へ

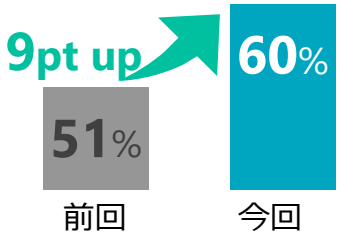
RESONAC

エンゲージメントスコア

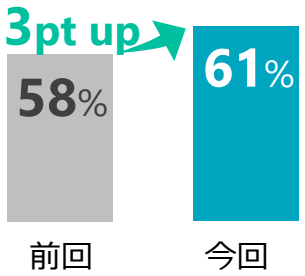


回答者数
21,002人
対象者数
25,452人
調査回答率
83%
（対前回＋18pt）

心理的安全性



仕事のやりがい



※前回調査：2021年9月、今回調査：2023年7月　実施

今後のアクション

従業員からのフィードバックが経営施策に反映されていない	▶	**従業員の皆さんとの双方向コミュニケーション**
生産性の悪い業務プロセスの存在	▶	**業務プロセス変革**を全社活動として推進
従業員へのキャリア開発支援が不十分	▶	**キャリア情報拡充**、**自己成長を支援**する**対話機会の創出**
全社・職場における**エンゲージメント向上の土台**	▶	**心理的安全性の確保**

©Resonac Holdings Corporation All Rights Reserved.

私たちがお伝えしたいこと

RESONAC

目標	売上高 1兆円超	EBITDA 20%	PBR 1倍超
Say&Do	半導体成長分野への積極投資 共創型イノベーション創出加速 カルチャー変革&人材開発	＋	市場環境の改善と機会の活用 内部効率化 ポートフォリオの最適化
現状	売上高 1.3兆円	EBITDA 8.2%	PBR 0.9倍

©Resonac Holdings Corporation All Rights Reserved.

RESONAC

Chemistry for Change

注意事項

本資料に掲載されている当社の業績に関する予想等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報および将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としております。

なお、法令に定めのある場合を除き、当社はこれらの将来予測に基づく記述を更新する義務を負いません。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。業績に影響を与える要素には、世界的な政治情勢、経済情勢、規制の強化、製品の需要動向および市況、為替レートなどが含まれますが、これらに限定されるものではありません。

©Resonac Holdings Corporation All Rights Reserved.